

國立清華大學半導體研究學院 碩、博士班研究生【院辦畢業離校手續單】

☐碩士班/☐博士班 部別：_____ 學號：_____ 姓名：_____

◆ 同學請完成以下各欄位所列內容：

1、論文線上建檔： 圖書館全文檢核通過日期	☐ 圖書館全文檢核通過_____年_____月_____日 ☐ 請同學檢附『圖書館檢核通過』通知之電子郵件紙本
2、學科實驗室	☐ 指導教授同意學生可以離校 _____【請指導教授『勾選』與『簽名』】
3、實驗室計畫薪資 (含國科會及產學合作計畫)	☐ 辦理離校手續時 <u>仍</u> 領有實驗室計畫薪資，已向計畫業務承辦人員辦理薪資停發手續。 ☐ 辦理離校手續時 <u>未</u> 領有實驗室計畫薪資。 _____【請計畫承辦人員或指導教授『簽名』或『蓋章』】 ☐ 請同學檢附計畫薪資請領資料(如官網公告附件之範例)
4、學院獎學金【院辦核實】	☐ 辦理離校手續時 <u>仍</u> 領有學院獎學金，已向業務承辦人員辦理停發手續。 ☐ 辦理離校手續時 <u>未</u> 領有學院獎學金。 _____【請學院承辦人員『簽名』或『蓋章』】
5、外語能力檢定 【請同學填寫】	☐ TOEFL iBT_____分(測驗日期：_____年_____月_____日) ☐ TOEIC_____分(測驗日期：_____年_____月_____日) ☐ IELTS_____分(測驗日期：_____年_____月_____日) ☐ 全民英檢_____級(測驗日期：_____年_____月_____日) ☐ 日語檢定_____級(測驗日期：_____年_____月_____日) ☐ 未參加(或通過)任何語文檢定
6、實習資訊 【請同學填寫】	☐ 在學期間(含寒暑假)曾於_____年_____月至_____年_____月 在_____ (企業/機構)實習 ☐ 在學期間(含寒暑假)不曾參與實習
7、參與國內/外研討會或 論文發表(含期刊及研討會) 【請同學填寫】	☐ 在學期間曾參與國內/外研討會或論文發表，資訊已填寫於google表單， 連結： https://forms.gle/mwJAY9adBq9ADEZZA ☐ 在學期間未曾參與任何國內(外)研討會或論文發表
8、畢業動向 【請同學填寫】	☐ 就業：_____公司(職稱_____) ☐ 研發替代役：_____公司(職稱_____) ☐ 一般替代役(警察役、消防役、社會役、環保役、醫療役、教育服務役、農業服務役及其他經行政院指定之役別。) ☐ 常備役(常備軍官役、預備軍官役、常備士官役、預備士官役、常備兵役、補充兵役) ☐ 升學：_____學校_____系所 ☐ 其他(如待業、公職考試準備、回家幫忙等)： _____
9、應屆畢業生問卷【院辦核實】	☐ 已填寫應屆畢業生問卷(問卷請參考第二頁)
10、國立清華大學學位論文符合 學術倫理聲明書【院辦核實】	☐ 已填寫國立清華大學學位論文符合學術倫理聲明書
☐ 已繳交電子檔論文定稿【院辦核實】	
☐ 同意完成系所離校手續_____【本表由院辦承辦人員簽章後留存院辦公室】	

(續接第二頁：應屆畢業生問卷)

國立清華大學半導體研究學院 碩、博士班畢業生問卷調查表

本問卷調查表是教育部所需之教學佐證資料，希望了解同學在清華大學半導體研究學院碩、博士班學習期間，是否已學習並具備半導體相關系統專業領域相關之核心能力。

一、應屆畢業同學基本資料

☐碩士班 / ☐博士班 部別：☐元件部 / ☐設計部 / ☐材料部 / ☐製程研發部

學號：_____ 姓名：_____ 身分別：☐一般生 ☐在職生 ☐外國學生

入學年月：_____/_____/_____ 口試年月：_____/_____/_____

二、本院碩、博士班教學成效意見調查(請勾選)

本院碩、博士班之教育目標：鑄造半導體科技所需要有的創新突破動力的領導人物。期望學院畢業生專、通、活三才具備。專才，在特定領域鑽研高深學問；半導體牽涉甚廣，故須具備廣大視野與半導體通識，與不同領域專才溝通合作，此為「通才」；又專又廣的人才必須具備解決新問題能力與開闢新領域的創意，故為「活才」。

為達成此教育目標，本院碩、博士班規劃並開授半導體專業領域相關課程，以建構培養學生具有問卷所列之十項核心能力。本問卷希望能了解您具有十項核心能力之信心度，以作為未來修正教育目標及改善課程與教學之參考。敬請依您的感受勾選下表問卷，謝謝。

本院碩博士班課程希望能培養學生具下列核心能力：	此項核心能力重要					您已具備此項能力				
	非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意	非常同意	同意	普通	不同意	非常不同意
	(5分)	(4分)	(3分)	(2分)	(1分)	(5分)	(4分)	(3分)	(2分)	(1分)
1. 充實的半導體系統專業領域相關之科學及工程知識。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. 具收集、分析及理解專業領域知識的能力。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. 發掘專業領域問題並研究新的工程方法以獨立解決問題之能力。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. 具創新設計、發明或改進半導體系統的能力。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. 策劃與執行專題研究，以及團隊合作所需之組織、溝通及協調整合的能力。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. 設計執行半導體系統研究所需實驗、分析數據及歸納結果的能力。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. 依學習或研究成果撰寫技術報告及論文之能力。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. 掌握科技趨勢，並了解科技對人類、環境、社會及全球的影響。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. 理解專業倫理及社會責任。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. 專業的外語能力及與國際專業領域社群互動的能力。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

三、畢業同學建言